



QVI® SNAP™ DM200

SNAP DM200在其宽大的78毫米视场内能够测量任何工件。远心光学镜头在最高放大倍率下精确测量超过35mm厚的工件，或在最低倍率下测量达75mm厚的工件。

- 250 x 100 mm 的测量行程以及为大尺寸零件量身定做的移动平台
- Auto-ID 可以识别可视范围内的所有工件，甚至多个不同工件
- 独有的变焦 Anywhere™技术 可以在可视区域的任何地方放大并测量细节尺寸
- SNAP DM200 可以快速自动测量，而不用考虑工件的定位

SNAP 全能数字影像测量仪系统

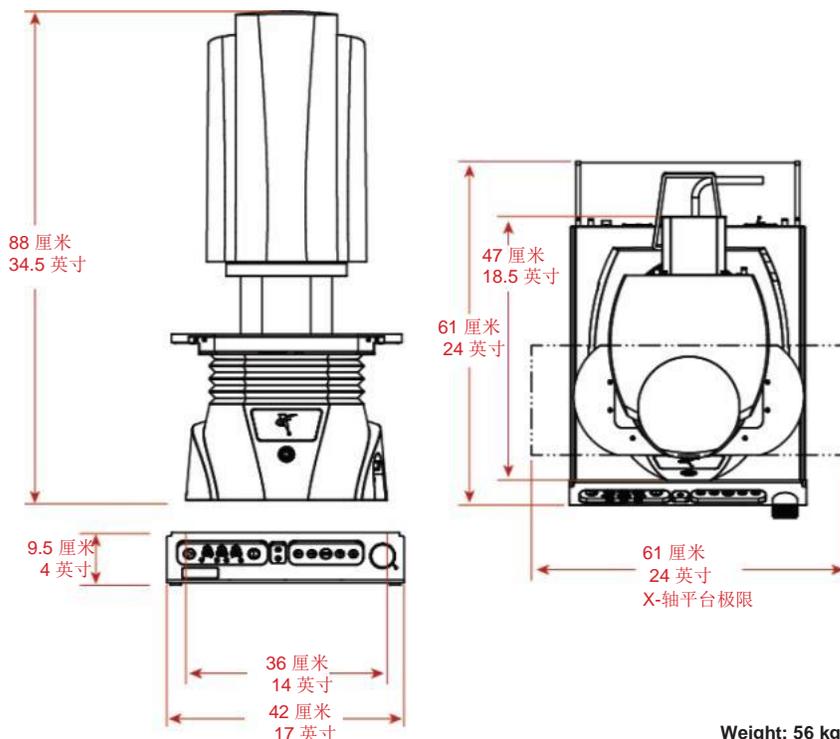
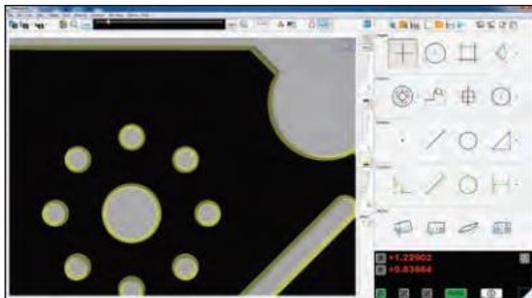


测量软件

SNAP 测量软件可以在一个程序内完成一整套的特征测量,无论有多少个测量点或测量步骤

运行一个工件测量程序,只需放上工件并按下 

SNAP 可以自动识别工件及其方向,无需手动调节. 程序也很简单,从CAD导入开始,测量样件,或放置好一个工件后,直接测量.



Weight: 56 kg
125 lb

	标配	选配
测量单元	带镀镍平台的铸铝基座,可用手柄上下调节75毫米	
测量范围	X: 250 毫米, Y: 100 毫米, Z: 75 毫米 X: 10 英寸, Y: 4 英寸, Z: 3 英寸	
平台	镀镍平台 可以放入玻璃块以及定位孔 4 kg (8.5 磅) 负载能力, 均匀分布, 电动垂直位置调整	旋转分度器
平台移动范围	X: 150 毫米, Z: 75 毫米 X: 6 英寸, Z: 3 英寸	
光学系统	百分百远心镜头	
视场	低倍率: 100 mm (4 in) 高倍率: 25 mm (1 in)	低倍率: 78 mm (3 in) 高倍率: 19.5 mm (0.75 in)
景深	低倍率: 38 mm (1.5 in) 高倍率: 4.75 mm (0.2 in)	
照明	All-LED, 光显微镜下的剖面光, 同轴面光, 8扇区可编程环形光	
相机	QVI 数码兆像素, 黑白, 像素大小 5.5 μm	QVI 高密度数码兆像素, 黑白; 像素大小 2.2 μm
图像处理	SNAP先进的图像分析, 256级灰度, 10:1 - 50:1 次像素分辨率	
控制单元	按钮移动控制X and Z, 旋转拔好定位 X, 灯光控制, 开始/停止	
控制系统	Windows™ 控制器, 高速/Bus ICORE 5 四核 CPU, 4 GB RAM, 160 GB 硬盘, 8 MB 缓存, 串口 ATA DVD/RW	单一平板LCD显示器, 或双液晶平板显示器, 鼠标键盘
相关环境	20 ± 2° C (额定), 15-30° C (最大. 操作范围)	
电源	115 ± 10% / 230 ± 10% VAC, 50/60 Hz, 1 phase, 160 W	
精度(E _z)	低倍率	高倍率
	10 μm + L/150*	5 μm + L/150*

* L = 测量长度(毫米). 适用于每个光学放大下的最小视场大小. QVI校准块 P/N 638696用于低倍放大和高倍放大. 校准块必须放在标准测量平面上. 定义垂直于光学轴在0.5毫米或0.02英寸以及5毫米或0.2英寸范围内为最佳聚焦距离. 重量不超过2.5千克或5磅, 且均匀分布在工作台面上. 适用于在相关环境下校准和工作的热稳定系统